

31. 3. 2004

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類は下記の出願書類の謄本に相違ないことを証明する。 This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月22日

出 願 番 号 Application Number:

PCT/JP03/09258

出 願 人 Applicant (s):

松下電工株式会社

元部 英次 日比野 明憲 伊藤 克彦

REC'D 2 1 MAY 2004

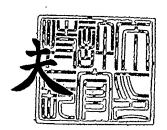
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004 年 4 月30.日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



出証平 16-500139

受理官庁用写し

特許協力条約に基づく国際出願

願

書

国際出願番号	- 受理官庁記入欄 ————————————————————————————————————
国際出願日	22.07.03
(受付印)	

出願人は、この国際出願が特許協力条 PCT International Application 約に従って処理されることを請求する。 _____ __国 出願人又は代理人の香類記号 PCT-55 (希望する場合、最大12字) 第 I 欄 発明の名称 印刷配線板用樹脂組成物、プリプレグ、積層板、及びこれを用いたプリント配線板 第工欄 出願人 この欄に記載した者は、発明者でもある。 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は鄭便番号及び国名も記載) 電話番号: 06-6908-5591 松下電工株式会社 ファクシミリ番号: Matsushita Electric Works, Ltd. 06-6906-3771 加入電信番号: 〒571-8686 日本国大阪府門真市大字門真1048番地 1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 出願人登録番号: 国籍(国名): 日本国 JAPAN 住所(固名): 日本国 JAPAN この欄に記載した者は、次の ✔ 米国を除くすべての指定国 すべての指定国 追配欄に配載した指定国 米国のみ 指定国についての出順人である: 第皿欄 その他の出願人又は発明者 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は鄭便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は 次に該当する: 英次 MOTOBE, Hidetsugu 出願人のみである。 松下電工株式会社 Matsushita Electric Works, Ltd. ✔ 出願人及び発明者である。 〒571-8686 日本国大阪府門真市大字門真1048番地 発明者のみである。 (ここに*レ印を付したときは、* 以下に記入しないこと) 1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 出顧人登録番号: 国籍 (国名): 日本国 JAPAN 住所(国名): 日本国 **JAPAN** この棚に配載した者は、次の すべての指定圏 米国を除くすべての指定国 ✔ 米国のみ 適配権に配戴した指定圏 指定国についての出題人である: ✔ その他の出願人又は発明者が統築に記載されている。 第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 次に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: / 代理人 共通の代表者 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び固名も記載) 電話番号: 06-6356-8885 9168 弁理士 吉川 俊雄 YOSHIKAWA Toshio ファクシミリ番号: 06-6356-8883 〒534-0024 日本国大阪府大阪市都島区東野田町4丁目9番19号 村浜ビル6階 加入電信番号: Murahama Bldg., 6F, 9-19, Higashinoda-cho 4-chome, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0024 JAPAN 代理人登録委号:

様式PCT/RO/101 (第1用紙) (2001年3月版)

皿棚の続き その	の他の出願人又は	発明者		
	この続葉を使	用しないときは、この用紙を	変化をはよい。	
氏名 (名称) 及びあて名:(姓・	名の順に記載:法人は公式の	完全な名称を記載;あて名は即便は	関番に含めないこと。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日比野 明憲 HIBII	NO, Akinori	ここは石がを記載;めて名は郵便を	ドサ及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:
〒 571-8686 日本国	大阪府門真市大字門.	真1048番地		出願人のみである。
松下電工株式会社内		•		✔出願人及び発明者である。
c/o Matsushita Electr	ic Works, Ltd.,	•		
1048, Oaza-Kadoma Osaka 571-8686 Jap	, Kadoma-shi,			
Озака 371-0006 Јар	an			以下に記入しないこと)
				出願人登録番号:
	JAPAN	住所 (国名):	日本国 JAP	AN
この欄に配載した者は、次の 指定国についての出願人である:	すべての指定国	米国を除くすべての指揮	☑ ✔ 米国のみ	追記欄に配載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓・名	名の順に記載;法人は公式の完	全な名称を記載;あて名は郵便番	号及び国名も記載)	この網に記載した省は
伊藤 克彦 ITO, Kai	tsuhiko			次に該当する:
	,			出願人のみである。
〒 571-8686 日本国大 松下電工株式会社内		【1048番地		出願人及び発明者である。
c/o Matsushita Electric	Works, Ltd			発明者のみである。
1048, Oaza-Kadoma.	Kadoma-shi			(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)
Osaka 571-8686 Japa	n			出願人登録番号:
	IAPAN	住所 (国名):	日本国 JAPA	
この棚に記載した者は、次の	すべての指定國			NV .
首定国についての出願人である: 大名(名称)及びあて名:(佐・名	(四周)"阳静,孙儿孙	米国を除くすべての相定	四	- 追記機に記載した指定圏
大名(名称)及びあて名: (姓・名	の順に配収;法人は公式の完全	全な名称を記載;あて名は郵便番号	みび国名も記載)	この欄に記載した者は
				次に該当する:
				出願人のみである。
•				出願人及び発明者である。
	•			発明者のみである。
				(ここにレ印を付したときは、 以下に配入しないこと)
				出願人登錄番号:
籍(固名):		住所 (国名):		
の欄に記載した者は、次の 定国についての出願人である:	すべての指定国	米国を除くすべての指定国	米国のみ	追配欄に配轍した指定国
- 、日刊が及びめて名:(姓・名が	の順に記載;法人は公式の完全	な名称を記載; あて名は郵便番号。	及び国名も記載)	この網に記載した者は
				次に該当する:
,				出願人のみである。
				出願人及び発明者である。
				発明者のみである
				(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)
				出願人登録番号:
報 (四名): の欄に記載した者は、次の [住所 (国名):		
区国についての出願人である:	すべての指定国	米国を除くすべての指定国	米国のみ	追記欄に記載した指定国
その他の出願人又は発明者が他の		-		
CT/RO/101 (放棄) (2	001年8月版)			



が 園の指定

(該当する口にレ印を付すこと:少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。

規則 4 9(a)の規定に基づきなの場合との	ことはを付すこと:少なくとも1つの口にと印を付すこと) <u>.</u>
広山文字音午	類の保護又は取扱をいずれかの指定国(又は OAPI)で3	とめる場合には追記欄に記載する。
図AP ARIPO特許・CH	H-+ Chair and a series	
S Z スワジランド Swaziland っ	ゲーナ Ghana,:G Mガンピア Gambia,K E グ モザンピーク Mozambique,S Dスーダン Suds 「 Z タンザニア United Republic of Tongonia	un, SLシエラ・レオネ Sierra Leone
Z Wジンバブエ Zimbabwe, 及び	ドハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である	U Gワガンタ Uganda, Z Mザンピア Zambia, 他の国 <i>(他の種類の保護マけ取り扱いも</i> からである。
K G キルギスタン Kyrgyzstan, Federation, T J タジキスタン 7 統約国である他の国	K Zカザフスタン Kazakhstan, MDモルドウ Tajikistan, TMトルクメニスタン Turkmenista	Francisco Y ベフルーシ Belarus, Fr Republic of Moldova, R Uロシア Russian III. 及びユーラシア特許各約と特殊的力を外の
プログラーロッパ特許:ATォースイス及びリヒテンシュタインの	ーストリア Austria, B E ベルギーBelgium,	B Gブルガリア Bulgaria。C H and T T
フランス France, G B 英国 Unit	enmark, E E エストニア Estonia, E Sスペ ed Kingdom, G R ギリシャ Greece, I E アー	が C と C T T T C C Zech Republic, D E ドイ イン Spain, F I フィンランド Finland, F R イルランド Ireland, I T イタリア Italy, T I I
CGコンゴCongo C I コート	キナ・ファソ Burkina Faso, B Jベナン Benin	未耐る特許協力条約の締約国である他の国 , C F 中央アフリカ Central African Ropublic
G Q 赤道ギニア Equatorial Guine E ニジェール Niger S N オラナ	a, GWギニア・ビサオ Guinea-Bissau, ML	roon, GAアボン Gabon, GN ギニア Guinea, マリ Mali, MR モーリタニア Mauritania N
のり特許協力条約の締約国である他の	の国(他の種類の保護又は取り扱いを求める場合に	bgo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国で には点線上に配載する)
上 国内特許 (他の種類の保護又は取り扱いを)	求める場合には点線 トに記申ナス)	
🏳 🕰 こ / フノ自長国連邦	図 G E グルジア Georgia	図 N Zニュー・ジーランド New Zealand
United Arab Emirates	ピーG Hガーナ Ghana	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Antigua and Barbuda	E G Mガンピア Gambia	図 OMオマーン Oman
図ALアルバニア Albania	回HRクロアチア Croatia	図 P Hフィリピン Philippines
UANI/ルメニアArmenia	TT	UP L ホーフンド Poland
1 C A I T - X F J T Austria	The second secon	L P Tポルトガル Portugal
」 CJ AS U オーストラリア Australia		世 R Oルーマニア Romania
MA Zアゼルバイジャン Azerbaijan	図 I Sアイスランド Iceland	図RUロシア Russian Federation
回 B Aボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia	図JP日本Japan	図 S Dスーダン Sudan
and Herzegovina	図KEケニアKenya	図 S Eスウェーデン Sweden
) Ľ B B ベルバドス Barbados	☑ K Gキルギスタン Kyrgyzstan	図 S G シンガポール Singanore
図BGブルガリア Bulgaria	図 K P 北朝鮮	図SIスロヴェニアSlovenia
「ロロスファシル Brasil	Democratic People's Republic of Korea	LIS KADDr+T Slovakia
ロロロエへフルーシ Relarus	区 K R 韓国 Republic of Korea	LOS Lシエラ・レオネ Sierra Leono
ロ B とへリース Belize	図 K Zカザフスタン Kazakhstan	図 T J タジキスタン Todilbioton
LI C A カナタ Canada	D L Cセント・ルシア Saint Lucia D L Kスリ・ランカ Sri Lanka	ビ T Mトルクメニスタン Turkmenistan
回 C Hand L I スイス及びリヒテンシュタイン	D L R リベリア Liberia	*************
OWITZEILand and Liechtenstein		図 T Nテュニジア Tunisia
· I C N中国 China	□ L S レソト Lesotho □ L T リトアニア Lithuania	☑ TR トルコ Turkey
Colombia	区 L Uルクセンブルグ Luxembourg	ピーエ エトリニダッド・トパゴ
ピーC R コスタリカ Costa Rica	回 L Vラトヴィア Latvia	Trinidad and Tobago
Cuba	MATPUT Morocco	凹 T Z タンザニア
C Z Tx = Czech Republic	☑MDモルドヴァ Republic of Moldova	United Republic of Tanzania
C P F 1 7 Germany	********	凹 U A ウクライナ Ukraine
D D M K s - + P	LLIM Gマダガスカル Madagageer	D U G ウガンダ Uganda
D D Mドミニカ Dominica	Ψ」№ 15、マケドニア旧ユーゴスラヴィア	*******
	共和国 The former Yugoslav Republic of	U U Z ウズベキスタン Uzhekistan
図 E Cエクアドル Equador	Wacedonia	☑ V Nベトナム Viet Nam
日 E E エストニア Estonia	WIVIN モンゴル Mongolia	LE Y U ユーゴスラヴィア Yugoglavia
PIETO AND	☑ MWマラウイ Malawi	図 Z A南アフリカ共和国 South Africa
アイン D 生用ない 1 ***	ピンパスメキシコ Mexico	********
PIC DALLERO	LIVI と モザンピーク Mozambique	図 Z Mザンピア Zambia
以下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の	☑ N ○ ノルウェーNorway	図 Z Wジンパブエ Zimbabwe
	[···]	
		<u></u>
肯定の確認の官員・出版人は トロッドウェル・		
肯定の確認の宜旨:出顧人は、上記の指定に加えて、規則 50除く旨の表示をした固は、指定から除かれる。出願人は なされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって 「KMM 2 元数型の数数	4.8kD)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他 、これらの追加される指定が確認を条件としていること。 取り下げられたものとなわせた。	の全ての国の指定を行う。但し、追記欄にこの宣言か 、並びに優先日から15月が経過する前にその確認が

なされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。(指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及 び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から19月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

	4			73
 	 •••	 	 	я

石欄 優先権 :	主張			
以下の先の出願に基づく	優先権を主張する:			
先の出願日	先の出願番号		先の出順	
(日. 月. 年)		国内出願: パリ条約同盟国名又は WTO 加盟国名	広域出願:*広域官庁名	国際出願: 受理官庁名
(1)		·		
(2)				
(3)	·			
(4)				
(5)	•			
	 張(先の出願)が追記欄に 本国原出願の受理官庁に対		下のものについて、出願客類の8	忍証謄本を作成し国際事務局へ送付する
	特許庁の長官) に対して請求す		·権(4)	その他は追記欄参照:
		出願を行った工業所有権の保護のための		 B機関の加盟国の少なくとも1ヶ国を
第VII欄 国際關	查機関			
国際調査機関(記載。)	ISA)の選択(2以上の国際調査機関が国際調査を	実施することが可能な場合、	いずれかを選択し二文字コードを
I SA/.JP				
先の調査結果の 出願日(日.)		る金の照会(先の調査が、国際 出顧番号	関査機関によって既に実施又 国名(又は広域)	
第四欄 申立て	•			
この出願は以下の申え	エてを含む。 <i>(下配の該当</i>	する欄をチェックし、右にそれぞれ	の申立て数を記載)	申立で数
第VIII欄(i)	発明者の特定に	関する申立て		:
第WI楠(ji)	出願し及び特許出願人の資格に	を与えられる国際出願日 関する申立て	における	:
第VII楠(iii)	先の出願の優先 出願人の資格に	権を主張する国際出願日 弱する申立て	における	:
第VII桐(iv)	発明者である旨((米国を指定国	-		
第VIII棡(v)	不利にならない て	卵示又は新規性喪失の を	外に関する申立	:

_	
•	***

the state of the s	
「際出願の紙様式の枚数は次のとおりである。 氏形式での枚数	数
春(申立てを含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	:
細書(配列表を除く) 15 牧 が付する手数料に相当する特許印紙を貼付した客面	:
水の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: <u>/</u>
2.	:
3. □ 包括委任状の原本	:
4. 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)	:
5. 配名押印(署名)の欠落についての説明書	:
月細套の配列表部分	 :
7. 国際出願の翻訳文 (翻訳に使用した言語名を記載する):	:
合 計 23 枚 8. 新能した微生物又は他の生物材料に関する書面	:
コンピュータ読み取り可能な形式による配列表部分 9. コンピュータ読み取り可能なヌクレオチド又はアミノ酸配列: (単体の磁銀 (フィキンプルテ゚(スタ, CD-ROM, CD-R その値) と枚数も表示	・
(製) コンピュータ銃み取り可能な形式のみ 規則 13 の 3 に基づき拠出する国際調査のための写し	
(英麗神県第801号(A)(D) (佐藤(b)(D)にレ印を付した場合のみ)	が多し :
(ii) 無形式に追加 (実施細則第 801 号(a)(ii)) (iii) 原際調査のための写しの同一性、又は左綱に記載した 配列数部分を含む写しの同一性についての疎迹音を修付	:
配列表部分を含む媒体の種類 (フレマキンプルテ゚ィスタ、CD- ROM、CD-R その他) と枚数 10. こ	:
(追加的写しは右欄9. (山)に記載)	
「約費とともに提示する図面: なし 本国際出願の書語: 日本語	
吉川俊雄 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	2. 図面
3. 国際出願として提出された番類を備えずる各面又は国面であってその後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂正日)	不足図面がある
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日 5. 出願人により特定された T S A / プロ 6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に	
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	

様式PCT/RO/101 (最終用紙) (2001年3月版)

明細書

印刷配線板用樹脂組成物、プリプレグ、積層板、 及びこれを用いたプリント配線板

技術分野

本発明は、電気用積層板の製造に用いられる印刷配線板用エポキシ樹脂組成物、印刷配線板用プリプレグおよびこれを用いた電子機器等に用いられる印刷配線板用積層板、プリント配線板、多層プリント配線板に関するものである。

背景技術

印刷配線板用エポキシ樹脂の硬化剤としては、従来からDICY(ジシアンジアミド)が用いられてきた。しかし近年のプリント配線板の高密度配線化に伴い、長期絶縁信頼性の優れた(CAFが発生し難い)材料や鉛フリーはんだに対応するために熱分解温度の高い材料が求められるようになり、これらの特性に優れているフェノール系硬化剤が用いられるようになってきた。

しかし、フェノール系硬化剤は、ガラス基材への含浸性が悪く、プリプレグの外観が悪いといった問題があった。

プリプレグの外観改良については、特公平0.7-4.85.86や特公平0.7-6.83.80においてプリプレグの製造時にテトラプロモビスフェノールAとビスフェノールA型エポキシ樹脂及びノボラック型エポキシ樹脂とを反応させることにより、プリプレグへの含浸性を改善した例や、特許第3.39.58.45号において、軟化点6.0 \mathbb{C} ~ 9.0 \mathbb{C} のビスフェノールノボラック樹脂を用いることによるプリプレグの外観改良等が挙げられる。

発明の開示

本発明者らは、フェノール系硬化剤を用いた積層板用プリプレグにおいて、特定のシリカフィラーを用いることにより、プリプレグの外観改良に効果のあることを見出し本発明に到達した。

従来、フィラー(充填材)は、積層板の低 α 化や高剛性化、あるいは低吸水化を実現するために用いられることは良く知られている。具体的には特開平06-216484号公報に記載のように比表面積が小さく($0.2m^2/g\sim2.0m^2/g$)、球状の無機充填剤を用いることによって低吸水化を達成していた。

しかし、本発明者らは、フェノール系硬化剤を用いたエポキシ樹脂系において特定形状で、所定範囲の平均粒径、所定範囲の比表面積をもつシリカフィラーを、所定量含有させることにより、見かけの樹脂粘度を上昇させて乾燥機内での樹脂タレを抑制し、且つ、局部的には樹脂そのものの粘度は増加していないため補強材への浸透性は損なわれず、プリプレグの外観を改良できることを見いだすに至った。

本発明は、上記の問題を鑑みてなされたもので、その目的とするところは耐熱性に優れたフェノール系硬化剤を使用する系において、良好な外観を呈するプリプレグを提供することであり、更に、上記プリプレグを用いた金属箔張積層板を提供し、その金属箔張積層板を用いたプリント配線板を提供することにある。

発明の概要

上記目的を達成するために、本発明の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂、硬化促進剤およびシリカフィラーからなるエポキシ樹脂組成物であって、該シリカフィラーとして形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が $0.3\mu m$ 以上 $10\mu m$ 以下で、且つ、比表面積が $8m^2/g$ 以上 $30m^2/g$ 以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下配合させてなることを特徴とする印刷配線板用エポキシ樹脂組成物である。

本発明の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、好ましくは、形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が0.3μm以上10μm以下で、且つ、比表面積が10m²/g以上20m²/g以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下を含有している。

本発明の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、好ましくは、上記シリカフィラーとして、電気伝導度が $15 \mu s / c m$ 以下のものを使用している。

本発明の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、上記シリカフィラーとして、好ましくは、1800℃以上の温度で溶融し、ガラス化したものを使用している。

本発明の別の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、好ましくは、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、2官能フェノール類とビスフェノールA型エポキシ樹脂とを反応させたエポキシ樹脂含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下のものを使用している。

本発明の別の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、好ましくは、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、ジシクロペンタジエン骨格を有するエポキシ樹脂含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下のものを使用している。

一本発明の別の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、好ましくは、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、ノボラック型エポキシ樹脂含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下のものを使用している。

本発明の別の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、臭素を含有していない。

本発明のプリプレグは、上記印刷配線板用エポキシ樹脂組成物を補強

材に含浸・乾燥させ、Bステージ化して作製される。

本発明の積層板は、上記プリプレグを金属箔表面に張り合わせ、加熱・加圧して作製される。

本発明のプリント配線板は、上記金属箔張積層板を用いて作製される。

発明の詳細な開示

以下、本発明の実施の形態を説明する。

本発明に用いる印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂、硬化促進剤、シリカフィラーを含有することが必要であり、有機溶媒、その他、必要に応じてUV遮蔽剤や蛍光発光剤等を含有しても良い。

エポキシ樹脂としては特に限定されるものではなく、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、テトラブロモビスフェノールA型エポキシ樹脂等の2官能エポキシ樹脂、あるいはそれらの臭素化タイプ、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂、あるいはそれらの臭素化タイプ、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、テトラメチルピフェニル型エポキシ樹脂等のビフェニル型エポキシ樹脂、3官能型エポキシ樹脂や4官能型エポキシ樹脂等の多官能型エポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、あるいはそれらの臭素化タイプ等を用いることができ、これらは単独、若しくは2種以上混合して使用しても良い。

上記臭素化工ポキシ樹脂として、臭素含有率を樹脂固形分全体(シリカフィラーを含まない)に対して5重量%以上20重量%以下とし、2官能フェノール類とビスフェノールA型工ポキシ樹脂とを反応させた工ポキシ樹脂の含有率を工ポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下のものを使用すると、硬化物としてコストと難燃性のバランスの優れたものが得られ、好ましい。

又、臭素化エポキシ樹脂として、臭素含有率を樹脂固形分全体(シリカフィラーを含まない)に対して5重量%以上20重量%以下とし、ジ

シクロペンタジエン骨格を有するエポキシ樹脂の含有率をエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下のものを使用すると、硬化物の難燃性を確保しつつ低吸湿化が図れるので好ましい。

又、臭素化工ポキシ樹脂で、臭素含有率を樹脂固形分全体(シリカフィラーを含まない)に対して5重量%以上20重量%以下とし、ノボラック型エポキシ樹脂の含有率をエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下とすると、硬化物のガラス転移温度が高くなり、難燃性も確保できるため好ましい。

又、臭素を含有しないエポキシ樹脂を用いたものはいわゆるハロゲンフリーで、環境負荷が少なく、好ましい。

本発明の硬化剤であるフェノールノボラック樹脂としては、特に限定はされないが、例えばフェノール、クレゾール等のフェノール類とホルムアルデヒドを反応させて得られるフェノールノボラック樹脂や、ビスフェノールA等のビスフェノール類とホルムアルデヒドを反応させて得られるフェノールノボラック樹脂が挙げられ、これらは単独で使用しても良く、若しくは2種以上併用しても良い。

又、硬化剤であるフェノールノボラック樹脂を、本発明のエポキシ樹脂組成物の1成分として混合する場合、エポキシ基とフェノール性水酸基との当量比を1:1.2~1:0.7の範囲とすることで、硬化物のガラス転移温度やピール強度等性能のバランスが良くなり、好ましい。

本発明の有機溶媒としては、メチルエチルケトンやシクロヘキサノン等のケトシ類や、メトキシプロパブール等のセロフルブ類を使用するのが好ましい。

本発明の硬化促進剤としては、特に限定するものではないが、2-メ チルイミダゾール、2-エチルー4-メチルイミダゾール、2-フェニ ルイミダゾール、1-シアノエチルー2-エチルー4-メチルイミダゾ ール等のイミダゾール類、ベンジルジメチルアミン等の三級アミン類、 トリブチルホスフィン、トリフェニルホスフィン等の有機ホスフィン類、 イミダゾールシラン類が例示でき、これらは単独で用いても良く、2種 類以上併用しても良い。

本発明のシリカフィラーとしては、形状が少なくとも 2 面以上の平面を有し、平均粒径が 0 . 3 μ m以上 1 0 μ m以下で、且つ、比表面積が 8 m^2 / g以上 3 0 m^2 / g以下、好ましくは 1 0 m^2 / g以上 2 0 m^2 / g以下のものが用いられる。

上記シリカフィラーの形状は、少なくとも2面以上の平面を有するもので、いわゆる球体ではなく、例えば破砕によって得られる不定形なものが挙げられる。

上記シリカフィラーにおいて、同様の粒径で比表面積が $8m^2/g$ 以下のものは樹脂の見かけの粘度上昇が少なく、乾燥時の液ダレ抑制効果が見られない。又、比表面積が $30m^2/g$ を超えるものは工業製品としては見当たらないため使用できない。

上記シリカフィラーの添加量は、樹脂固形分全体に対して3重量%以上50重量%以下であることが必要である。

上記シリカフィラーの添加量が上記範囲以下の場合、添加するメリットが発揮できず、上記範囲以上では基板としてのピール強度やドリル加工性に問題が発生するからである。

又、上記シリカフィラーの電気伝導度は、絶縁信頼性を確保するため、 $15 \mu s / c m$ (マイクロジーメンス/センチメートル)以下であることが好ましい。

又、上記シリカフィラーは、1800℃以上の温度で溶融しガラス化 したものが、硬化物の熱膨張率を低下させる効果があり、好ましい。又、 有害物質である結晶質が削除できるため、好ましい。

又、上記シリカフィラーは、シランカップリング剤等で表面処理を施 し、樹脂とシリカフィラーとの界面強度を増すのが好ましい。

本発明の印刷配線板用プリプレグは、例えば上記の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物を、前述した有機溶媒によってワニス化してガラスクロスに含浸し、120 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C} の乾燥機中でプリプレグの硬化時間が60秒以上180秒以下になるように乾燥させることによって半硬化

状態(Bステージ)にすることにより製造することができる。

本発明の印刷配線板用積層板は、例えば、上記プリプレグを所要枚数 重ね、これを140 \mathbb{C} \sim 200 \mathbb{C} 、0.98 MPa \sim 4.9 MPa (メガパスカル) の条件化で加熱・加圧して積層成形することによって、製造することができる。

このとき、所要枚数重ねた印刷配線板用プリプレグの片側、又は両側に金属箔を重ねて積層成形することにより、プリント配線板に加工するための金属箔張り積層板を製造することができる。ここで、金属箔としては銅箔、銀箔、アルミニウム箔、ステンレス箔等が用いられる。

そして、上記のようにして製造した印刷配線板用積層板の外層に回路 形成(パターン形成)することによって本発明のプリント配線板を製造 することができる。具体的には、例えば金属箔張り積層板の外層の金属 箔に対してサブトラクティブ法等を行うことによって回路形成するこ とができ、プリント配線板に仕上げることができる。

又、印刷配線板用プリプレグ、印刷配線板用積層板、及びプリント配線板のうち少なくとも何れかを用いて積層成形することによって多層プリント配線板を製造することができる。具体的には、例えば上記のように回路形成して仕上げたプリント配線板を内層用基板として用い、この内層用基板の片側、又は両側に所要枚数の印刷配線板用プリプレグを重ねると共にその外側に金属箔を配置し、金属箔の金属箔側を外側に向けて配置し、これを加熱・加圧して積層成形することによって多層積層板を製造することができる。このとき、成形温度は1-50℃~180℃の範囲に設定しておくことが望ましい。

又、ワニス化したエポキシ樹脂組成物を銅箔上にバーコーターを用いて塗布した後、160℃で約10分程度乾燥することにより、樹脂付き銅箔を製造することができる。

実施例

以下、本発明を、実施例を用いて具体的に説明する。

まず、使用したエポキシ樹脂、硬化剤、シリカフィラー、硬化促進剤、 添加剤、有機溶媒を順に示す。

エポキシ樹脂として、以下のものを使用した。

- エポキシ1:大日本インキ化学工業製 Epiclon153-60 M エポキシ当量400g/eq 臭素含有量48%(臭素化エポキシ樹脂)
- エポキシ2: Shell製 EPON1124-A-80 エポキシ 当量435g/eq 臭素含有量19.5%(2官能フェノール類 とビスフェノールA型エポキシ樹脂とを反応させたエポキシ樹脂)
- エポキシ3:大日本インキ化学工業製 Epiclon1120-8 0M エポキシ当量485g/eq 臭素含有量20%(2官能フェノール類とピスフェノールA型エポキシ樹脂とを反応させたエポキシ樹脂)
- エポキシ4:日本化薬製 BREN-S エポキシ当量285g/e q 臭素含有量35.5% (臭素化エポキシ樹脂)
- エポキシ5:東都化成製 YDCN-703 エポキシ当量210g /eq (ノボラック型エポキシ樹脂)
- エポキシ6:大日本インキ化学工業製 HP-7200H エポキシ 当量280g/eg (ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂)
- エポキシ7:大日本インキ化学工業製 Epiclon 850 エポキシ当量190g/eq (ビスフェノールA型エポキシ樹脂)
- エポキシ8:大日本インキ化学工業製 Epiclon N660 エポキシ当量210g/eq (クレゾールノボラック型エポキシ 樹脂)

硬化剤として、以下のものを使用した。

硬化剤1:ジャパンエポキシレジン製 YLH129B70

ビスフェノールA型ノポラック、水酸基当量118g/eq

硬化剤2:大日本インキ化学工業製 TD-2093

フェノールノポラック、水酸基当量105g/ea

硬化剤3:大日本インキ化学工業製 VH-4170

ビスフェノールA型ノポラック、水酸基当量118g/eq

硬化剤4:大日本インキ化学工業製 TD-2090

フェノールノボラック、水酸基当量105g/eq

硬化剤 5: 郡栄化学工業製 レジトップPSM-4324

フェノールノボラック、水酸基当量105g/ea

硬化剤 6:大日本インキ化学工業製 LA-7052

変性フェノールノボラック、水酸基当量120g/eg

シリカフィラーとして、以下のものを使用した。

シリカフィラー1: デンカ製 FS-2DC

熱処理有り、平均粒径;2.0μm、比表面積;11.4m²/g

形状;破砕、電気伝導度; 5. 1 µ s / c m

シリカフィラー2: 龍森製 クリスタライト 5 X

熱処理無し、平均粒径; 1.5μm、比表面積; 16.5m²/g

形状;破砕、電気伝導度; 2 μ s / c m

シリカフィラー3: 龍森製 ヒューズレックス AS-1

熱処理有り、平均粒径;3.0μm、比表面積;16.2m²/g

形状;破砕、電気伝導度;1μs/cm

シリカフィラー4: 龍森製 ヒューズレックス WX

·熱処理有り、平均粒径;1.2μm、比表面積:15.3m²/g

形状;破砕、電気伝導度;7 u s / c m

シリカフィラー5: デンカ製 FS-30

熱処理有り、平均粒径; 6.1μ m、比表面積;4.5m²/g

形状;破砕、電気伝導度; 2. 8 µ s / c m

シリカフィラー6:アドマテックス製 SO-С2

熱処理有り、平均粒径; 0.5μm、比表面積; 8m²/g

形状;球状、電気伝導度;7.8 µ s / c m

なお、比表面積はBET法による測定値、平均粒径はレーザー回折法により求めたd50の値とした。又、電気伝導度は、試料10gを10

0mlの精製水に加え、30分間振動後、抽出水を伝導度計にて測定した。

硬化促進剤としては以下のものを使用した。

促進剤1:四国化成製 2-エチル-4-メチルイミダゾール

添加剤としては以下のものを使用した。

添加剤1:大八化学工業製 PX-200 (難燃剤)

有機溶媒としては以下のものを使用した。

有機溶媒1:メチルエチルケトン

有機溶媒2:メトキシプロパノール

実施例1~8、比較例1~3

表1に示した物質を、表1に示した所定量(単位重量部)を配合し、約90分攪拌した後、ナノミルにてワニス中のシリカフィラーを均一に分散させ、実施例1~8、及び比較例1~3の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物(ワニス)を得た。

なおエポキシ樹脂組成物の臭素含有率は以下の方法により算出した。 {(各エポキシ樹脂の臭素含有率×固形分での配合量)の合計}を各エポキシ樹脂、硬化剤の固形分配合量の合計で割って100を掛ける。

〈印刷配線板用プリプレグの製造方法〉実施例 $1 \sim 8$ 、及び比較例 $1 \sim 3$ で得られた印刷配線板用エポキシ樹脂組成物のワニスを、厚さ0.2 mmのガラスクロス(日東紡(株)製「WEA7628」)にそれぞれ 含浸させ、乾燥機中($120 \sim 180 \sim$)でプリプレグの硬化時間が-60 か以上1-8-0 か以下、樹脂量が40 重量%あるいは50 重量%になるように乾燥させることによって半硬化状態(Bステージ)の印刷配線 板用プリプレグを製造した。

〈印刷配線板用積層板の製造方法〉上記のようにして得られた印刷配線板用プリプレグの樹脂量 40 重量%品を、4 枚あるいは 5 枚準備し、それらの両面に銅箔を重ね、これを 140 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C} 、0.98 MP a \sim 3.9 MP a の条件でプレスにより加熱・加圧して積層成形することによって板厚 0.8 mmあるいは 1.0 mmの銅張り積層板を製造した。

積層成形時の加熱時間は、印刷配線板用プリプレグ全体の温度が160 C以上となる時間が少なくとも60 分間以上となるように設定した。なお、銅箔としては、古河サーキットフォイル(株)製「GT」(厚さ; 18μ m)を用いた。

以上のようにして得られた印刷配線板用プリプレグ、印刷配線板用積 層板について、次に示すような物性評価を行なった。結果を表 2 に示し た。

〈プリプレグ外観〉上記の製造方法によって得られた印刷配線板用プリプレグの樹脂量50重量%品の外観を目視により観察した。

〈ガラス転移温度〉上記で得られた印刷配線板用積層板の銅箔をエッチングにより除去し、IPC-TM-650の2.4.25項に従い、DSC法により測定した。

〈難燃性〉難燃性の評価は、板厚0.8mmの銅張り積層板から表面の 銅箔をエッチングにより除去し、これを長さ125mm、幅13mmに 切断し、UL法(UL94)垂直燃焼試験に従って行った。

〈硬化時間測定〉上記によって作成したプリプレグをもみほぐして粉末とし、ガラス繊維等の異物を取り除くため、60メッシュのフィルター・を通した後、JIS-C6521の5.7項に従って測定した。

〈吸水率測定〉吸水率の評価は、板厚1.0mmの銅張り積層板から表面の銅箔をエッチングにて除去し、これを5.0mm角に切断したものを用い、PCT3気圧、3時間で処理し、下記計算式にて吸水率を求めた。

ĺ

-吸水率= {(処理後の重量-初期重量) /初期重量} ×100 (%)

〈評価結果〉表 2 に見られるように、形状が少なくとも 2 面以上の平面を有し、平均粒径が 0. 3 μ m以上 1 0 μ m以下で、且つ、比表面積が 8 m 2 / g以上 3 0 m 2 / g以下、好ましくは 1 0 m 2 / g以上 2 0 m 2 / g以下のシリカフィラーを含有している実施例 1 ~実施例 8 は、シリカフィラーが添加されていない比較例 1 や上記範囲外のシリカフィラーが添加されている比較例 2 、比較例 3 と比較してプリプレグの外観が良好であることを示した。

産業上の利用可能性

本発明の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂、硬化促進剤からなる樹脂組成物において、形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が 0.3μ m以上 10μ m以下で、且つ、比表面積が $8m^2/g$ 以上 $30m^2/g$ 以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下含有させたことで、見かけの樹脂粘度を上昇させて乾燥機内での樹脂タレを抑制し、且つ、局部的には樹脂そのものの粘度は増加していないため補強材への浸透性は損なわれず、プリプレグの外観を改良する効果を得ることができた。

本発明の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物において、形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が 0.3μ m以上 10μ m以下で、且つ、比表面積が $8m^2/g$ 以上 $30m^2/g$ 以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下含有させたことで、見かけの樹脂粘度を上昇させて乾燥機内での樹脂タレを抑制し、且つ、局部的には樹脂そのものの粘度は増加していないため補強材への浸透性は損なわれず、外観の良好なプリプレグを得ることができる。

本発明の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、シリカフィラーとして、電気伝導度が $15 \mu s / c m$ 以下のものを使用することにより、長期絶縁信頼性の優れたものが得られる。

本発明の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物は、シリカフィラーとして、 1800℃以上の温度で溶融し、ガラス化したものを使用することにより、有害物質である結晶質が削除することができる。

比較例3		112.5		0.01				i .	27.6							0.128						25.5		17.0	26.0	14.1%
比較例2		112.5	,	0.01		•		 	27.6		ļ					0.128			-		25.5			17.0	26.0	14.1%
上較例1		112.5		0.0				1	27.6							0.128								18.5	18.5	14.1%
実施例8				•		100.0					:	95.2				0.120		157	2					43.0	1	%0.0
実施例7		•			100.0			-		55.3				40.0	027	0.150	307	0.0						75.0	25.0	%0.0
実施例6	41.7		25.0	50.0						34.6					-000	0.00				13.5				18.0	38.2	15.5%
実施例5	1125	i	0	0.0							26.7				0000	0.000			31.7					7.7.7	22.7	13.9%
実施例4	66.7		-00	0.00	•			40.5							000	0/0.0	70.3	2						72.0	25.0	13.7%
実施例3	16.7	:					41.1								000	0.120				19.3				•	28.0	17.4%
実施例2	41.7		0.62	50.0	- - -					34.6	_		_	-	7.00	2000	- -		26.9	-			0	0.0	38.2	 15.5%
実施例1	:	112.5	10.0	2	:				27.6						0 198	0.120		25.5					7,	2:/-	26.0	14.1%
	ドボキシュ ドボ・シュ	エポキンの	ー ドキン4 ドキシロ	ドボルン6	エポキシフ	エポキシ8	硬化剤1	硬化剤2	硬化剤3	硬化剤4	硬化剤5	硬化剤6		添加剂1	化准数1	W.VETTI 1	シリカフィラー1	シリカフィラー2	シリカフィラー3	シリカフィラー4	シリカフィラー5	シリカフィラー6	九 载於每 7	11. 成在然一	有碳浴碟2) (本に対し)
組成物	ードポル 歯脂・ツ						硬化剤						7 -7 -1	発温を	世界 世界 世界		シリカフィラー						九排沙姑	İ		 吴紫宮有举(%) (樹脂固形分全体に対し)

	*	19.5% 2官能フェノール類とビスフェノールA型エホーキシ樹脂とを反応させたTホートン樹脂	20.0% 2官能フェノール類とビスフェノールA型エボキシ樹脂とを反応させたエホ キン樹脂	35.5% 臭素化エポキン				クレゾールノボラック型エボキシ		ビスフェノールA型ノボ・ラック	フェノールノボ・ラック	ビスフェノールA型ノボ・ラック	フェノールノボ・ブック	フェノールノボ・ラック	変性フェノールバデック					北 聚面積	11.4m²/g 破砕	16.5m²/g 破碎	$16.2 \text{m}^2/\text{g}$	$15.3m^{2}/g$	4.5m²/g 破砕	n 8.0m²/g 球状 7.8μs/cm
/当量 臭素含有量					eq pa	ed be	- be	- be	水酸基当量	be	ed	ed	eđ	ed	ed					里 平均粒径	2.0 μ m	1.5 μ m	3.0 μ m	1.2 μ m	6.1 μ m	0.5 μ m
エポギン当量	400g/eq		1 485g/eq		210g/eq	280g/eq	190g/eq	210g/eq	水酸基	118g/eq	105g/eq	118g/eq	105g/eq	4 105g/eq	120g/eq				レイミダゾール	熱処理	有り	無し	有り	有り	有り	有り
商品名	大日本インキ化学工業 Epiclon 153-60M	EPON1124-A-80	工業 Epicloh1120—80N	日本化業 BREN L-S	YDCN:703	L業 HP-7200H	大日本化学工業 Epiclon 850	L業 Epiclon N660	商品名	v YLH129B70	L業 TD-2093	工業 VH-4170	北	レジトップPSM-4324	工業LA-7052	商品名	PX-200	商品名	ナメー	商品名	FS-2DC	クリスタライト 5X	E2-7'L"77 AS-1	L1-7'L")7 WX	FS-30	S0-C2
メーガーメ	大日本47年化学。	Shell	大日本44代学1	日本化薬	東都化成	大日本474化学1	大日本44件。	大日本インキ化学.	トナーメ	シャハットボ・キシフシン	大日本个4化学1	大日本(24化学)	大日本化斗化学工艺	郡栄化学工業	大日本小+化学工業 LA — 7052	ーナーメ	大八化学工業製	メーガー	四国化成製	メーガー	デンカ	龍森	龍森	藍茶	デンカ	アト *マ テ ックス
	エポキツ1	エポキシ2	エポキシ3	エポキツ4	エポキシ5	エポキツ6	上ポキツ7	エポキシ8	•	硬化剤1	硬化剤2	個化強3	硬化剤4	個化剤5	庫化塑6		添加剤1		促進剤1		シリカフィラー1	シリカフィラー2	シリカフィラー3	シリカフィラー4	シリカフィラーち	シリカフィラー6

有機溶媒1 メチルエチルケトン 有機溶媒2 メトキシプロパノール

比較例3	20部	0.5	8.0	松、	有り	7.8		樹脂が有		N-0	137°C	0.45
比較例2	20部	6.1	4.5	安却	有り	2.8		樹脂が有		0-/	137°C	0.47
比較例1	無し	1	1	ı	.1	1		樹脂が有	1	0->	137°C	09.0
実施例8	峥 01	3.0	16.2	母母	有り	1.0		良好		0-/	160°C	0.40
実施例7	30部	2.0	11.4	破砕	有り	5.1		良好		0-/	113°C	0.61
実施例6	10%	12	15.3	母母	有り	7.0		良好	1	0->	165°C	0.36
実施例5	25部	3.0	16.2	破碎	有じ	0.		良好		0->	-	0.45
実施例4,	50部	2.0	11.4	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	有い	5.1	-	良好		0->	175°C	0.30
実施例3	15組	1.2	15.3	世籍	中に	7.0		良好		0->	135°C	0.51
実施例2	20時	3.0	16.2	1 世	· 元 三 二	200		良好		0-1>	-ا(0.31
宇格堡1	20年	, 1 , 1	7.	2. 世	Į Į	2.0		良好		0-7	137%	0.47

i -

١..

特許請求の範囲

- 1. エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂、硬化促進剤およびシリカフィラーからなるエポキシ樹脂組成物であって、該シリカフィラーとして形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が $0.3\mu m$ 以上 $10\mu m$ 以下で、且つ、比表面積が $8m^2/g$ 以上 $30m^2/g$ 以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下配合させてなることを特徴とする印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 2. 請求項1記載のシリカフィラーとして、形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が 0.3μ m以上 10μ m以下で、且つ、比表面積が $10m^2/g$ 以上 $20m^2/g$ 以下のシリカフィラーを用いることを特徴とする請求項1記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 3. 請求項1記載のシリカフィラーとして、電気伝導度が $15 \mu s / c m$ 以下のシリカフィラーを用いることを特徴とする請求項1記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 4. 請求項1又は2記載のシリカフィラーとして、1800℃以上の 温度で溶融し、ガラス化したシリカフィラー用いることを特徴とする請 求項1または2記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 5. 前記エポキシ樹脂組成物として、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、且つ2官能フェノール類とピスフェノールA型エポキシ樹脂とを反応させて得られるエポキシ樹脂の含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下であるエポキシ樹脂組成物を用いることを特徴とする請求項1乃至3記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。

- 6. 前記エポキシ樹脂組成物として、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、且つジシクロペンタジエン骨格を有するエポキシ樹脂含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下であるエポキシ樹脂組成物を用いることを特徴とする請求項1乃至4記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 7. 前記エポキシ樹脂組成物として、臭素含有率がシリカフィラーを含まない樹脂固形分に対して5重量%以上20重量%以下であり、且つノボラック型エポキシ樹脂含有率がエポキシ樹脂固形分全体に対して40重量%以上100重量%以下であるエポキシ樹脂組成物を用いることを特徴とする請求項1乃至5記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 8. 前記エポキシ樹脂組成物が、臭素を含有していないエポキシ樹脂組成物であることを特徴とする請求項1乃至請求項4記載の印刷配線板用エポキシ樹脂組成物。
- 9. 請求項1乃至8の何れか1項に記載の印刷配線板用工ポキシ樹脂組成物を補強材に含浸・乾燥させ、Bステージ化して作製されてなることを特徴とする印刷配線板用プリプレグ。
- 10. 請求項9記載のプリプレグを金属箔表面に張り合わせ、加熱・加圧して作製されてなることを特徴とする印刷配線板用積層板。
- 11. 請求項10記載の金属箔張積層板を用いて作製されてなることを特徴とするプリント配線板。

要約書

エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂、硬化促進剤およびシリカフィラーからなるエポキシ樹脂組成物であって、該シリカフィラーとして形状が少なくとも2面以上の平面を有し、平均粒径が 0.3μ m以上 10μ m以下で、且つ、比表面積が $8m^2/g$ 以上 $30m^2/g$ 以下のシリカフィラーを、樹脂固形分に対して3重量%以上50重量%以下配合させてなることを特徴とする印刷配線板用エポキシ樹脂組成物は、見かけの樹脂粘度を上昇させて乾燥機内での樹脂タレを抑制し、且つ、局部的には樹脂そのものの粘度は増加していないため補強材への浸透性は損なわれず、プリプレグの外観を改良する効果を得る。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.